

環境に配慮してコストを削減する、低銀はんだ材料

Eco-friendly, cost reducible, low-silver soldering materials

M35 ～フロー用低銀材料～

ローコスト、スタンダード低銀材料

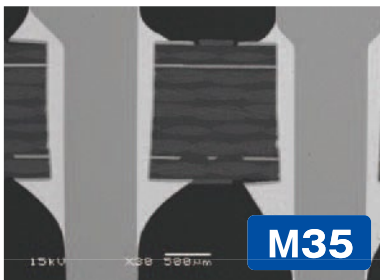
特長

- フロー用途、ローコスト鉛フリーはんだ Sn-0.3Ag-0.7Cu。
- 0.3%Ag添加で、Sn-Cu系はんだより濡れ性、機械的強度、信頼性が良好。
- リサイクルが容易なSn-Ag-Cuで設計。

製品仕様

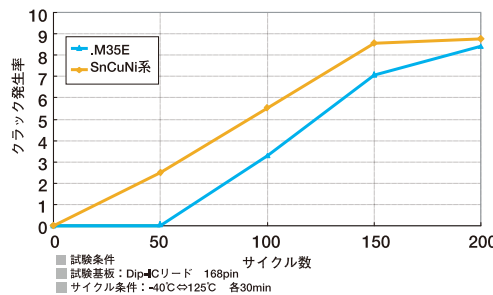
基本特性

- フローはんだ付け時のスルーホール上がり

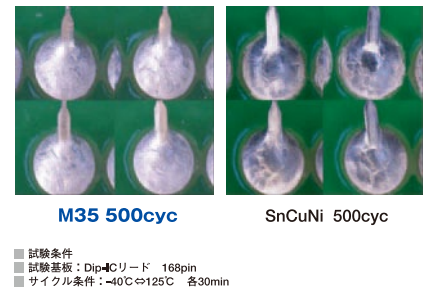


ヒートサイクル試験

測定方法:ウェットイングバランス法
フラックス:ロジン系液状フラックス
Cu板:30X10X0.3mm



ヒートサイクル試験後写真



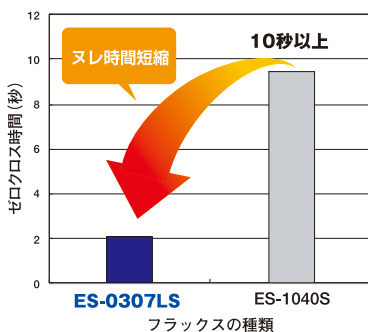
スパークルフラックス ES-0307LS

特長

- 低銀系、Sn-Cu系はんだにも良好な濡れ性。
- はんだ付け作業性に優れ、ブリッジが低減。

製品仕様

M35Eでのゼロクロス時間[酸化銅板]



試験装置: レスカSAT-5100
・ 浸漬深さ: 2mm
・ 浸漬速度: 10mm/sec
・ 浸漬時間: 10秒
・ はんだ温度: 250℃

銅板
・ 試験片サイズ (15×5×0.3)
・ 試験片処理
85℃、85%、24hr処理
・ フラックス塗布: 浸漬塗布後
過剰分をワイパーで除去

ES-0307LSは、従来フラックスよりスレが向上。

つや消し状態比較 (M24MT使用時)

